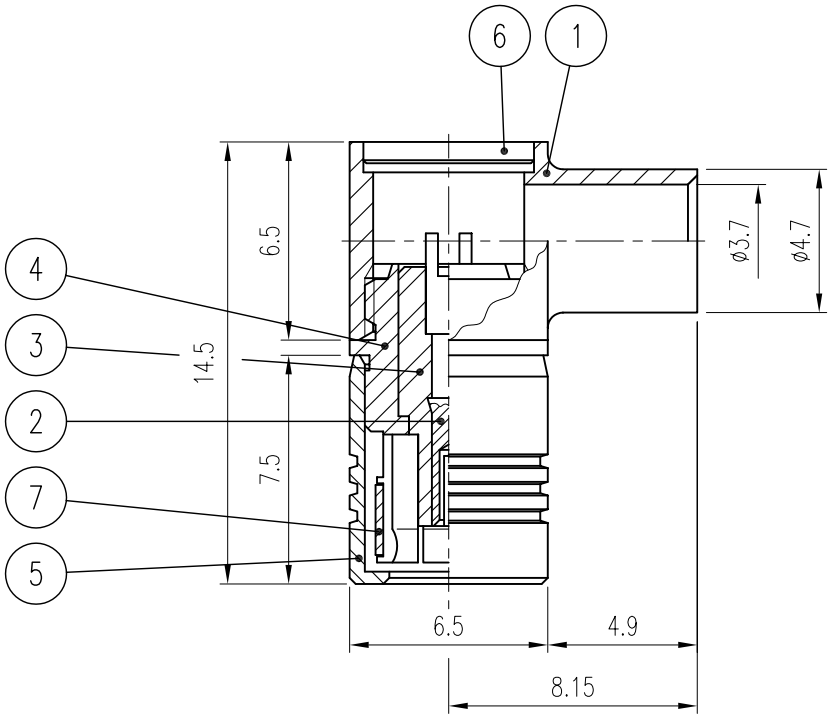
기공 / ST										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일



품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
7	SPRING RING	1	BeCu	Gold Plate	DSR00004-5/1 (R3001)
6	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00042-5/1 (L2003)
5	CAP	1	MBsBD	Gold Plate	DCU00023-5/1 (K3004)
4	JACK	1	MBsBD	Gold Plate	DJA00034-5/1 (J3014)
3	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00342-N/1 (H3012)
2	CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT00358-5/1 (E3007)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00459-5/1 (D3051)

대체가능재질

공통공차

소수 각도 분수

재질

열처리

보호피막처리

년월일	2001. 3. 5.
승인	
검도	
제도	
작성부서	연 구 소
척도	4/1
단위	mm
중량	

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 SMB-LPS-141

A4

도번 CN00204-7/1

K315-168-000